

<p><u>MAT:</u> Machine semi automatique de Flip Chip ultrason, de pick and place et d'encapsulation</p>		<p><u>PICK AND PLACE:</u> Machine de pick and place téléopérée</p>	
<p><u>WIRE BONDER:</u> Soudure filaire par ultrason : Wedge , ball and bump bonding en Alu et en Or</p>		<p><u>MACHINE D'USINAGE:</u> Pour le gravage de PCB</p>	
<p><u>PLASMA:</u> Traitement et activation de surface par ionisation de gaz</p>		<p><u>LEAK DETECTOR:</u> Détection de fuite d'He pour les boîtiers hermétiques</p>	
<p><u>PULL AND SHEAR:</u> Tests en traction et en cisaillement de soudure filaire et de colle ou brasure (1 gr à 5 kg)</p>		<p><u>STATION DE VISUALISATION:</u> Inspection visuelle de microsystemes</p>	
<p><u>SEAM SEALER:</u> Fermeture hermétique de boîtier électronique</p>		<p><u>METALLISEUR:</u> Dépôt Or sur PCB</p>	
<p><u>SCRIBER:</u> Découpe de gaufrettes en silicium</p>		<p><u>DECAPSULATION:</u> Enlèvement d'encapsulant par attaque acide</p>	

Remarque: Il est très important de comprendre que ces équipements ne sont pas associés à un secteur particulier et que l'ensemble de ces technologies permettent la réalisation complète d'un projet, allant jusqu'à la petite série. Il s'agit de technologies de pointe encore peu connues du monde industriel en dehors du secteur de l'électronique/microélectronique.